****

|  |  |
| --- | --- |
| **Вопросы читателей:** | **Контакты для прессы:** |
| **congatec AG** | **SAMS Network**  |
| Christian Eder | Michael Hennen |
| Phone: +49-991-2700-0 | Phone: +49-2405-4526720 |
| info@congatec.com[www.congatec.com](http://www.congatec.com/) | info@sams-network.com[www.sams-network.com](http://www.sams-network.com) |



*Текст и фото доступны на сайте: <https://www.congatec.com/ru/congatec-ag/press-reliz.html>*

**Представляем новый продукт**

Компьютеры на модуле congatec COM Express с новыми процессорами 8-го поколения Intel® Xeon® и Intel® Core™ (Coffee Lake H)

**Высокопроизводительный уровень six-pack от компании congatec для компьютеров на модулях Type 6**

**Деггендорф, Германия, 03 апреля 2018 г. \* \* \***компания congatec - ведущий поставщик стандартизированных и заказных плат встраиваемых компьютеров и модулей - параллельно с запуском в производство центральных процессоров 8-го поколения Embedded Intel® Xeon® и Intel® Core™ (кодовое название Coffee Lake H) представляет свои новейшие компьютеры на модулях conga-TS370 COM Express Type 6. Благодаря этому компания переводит класс модулей COM Express Type 6 с конструктивной мощностью по теплоотводу TDP в пределах 35-45 Вт на новый «six-pack» («шестипакетный») уровень высокопроизводительных встраиваемых компьютеров, впервые предлагая решение на уровне до 6 ядер / 12 потоков и впечатляющий тактовой частотой в режиме "турбо" до 4,4 ГГц, с возможностью подключения до трех независимых 4k UHD-дисплеев. Первоначальное тестирование, проведенное компанией congatec, показывает, что предлагаемые новые шестиядерные модули по сравнению с решениями на базе процессоров Intel® Core™ 7-го поколения обеспечивают повышение характеристик производительности на уровне от 45 до 50 процентов и более для многопоточных и от 15 до 25 процентов и более однопоточных решений. При заданном уровне TPD, системные проекты достигают более высокой пропускной способности при общем низком потреблении энергии, что в конечном итоге приводит к повышению эффективности конечной системы в целом. Целевыми приложениями для представляемых новых модулей являются высокопроизводительные встраиваемые и мобильные системы, промышленные и медицинские рабочие станции, серверы хранения данных и облачные рабочие станции, а также медиа-транскодирование и ядра краевых (периферийных) вычислительных систем.

«Такие рынки, как оборудование для медицинской визуализации и индустриальное, связанные с Индустрией 4.0, а также системы видеоаналитики, например, с возможностью ситуационной осведомленности и контроля за транспортом в реальном времени, широко открыты и охотно принимают любые новые предлагаемым улучшения в части производительности и эффективности встраиваемых компьютерных систем», - объясняет Мартин Данцер (Martin Danzer), директор по управлению продуктами в компании congatec. «Мы упрощаем использование возможностей, которые открываются благодаря повышению производительности, с помощью наших стандартизованных компьютеров на модулях, решений для охлаждения и eAPI, что делает модернизацию имеющихся систем до самых последних поколений процессоров задачей более или менее решаемой по типу plug & play».

Помимо повышения производительности, для новых модулей компании congatec гарантируются длительная доступность в течении не менее 10 лет, высокоскоростные входы/выходы (I/O) с поддержкой 4-x USB 3.1 Gen 2 (10 Гбит/с) и памяти Intel® Optane™, а также повышенная безопасность, включая расширения Intel® Software Guard, Trusted Execution Engine и технологию Intel® Platform Trust.

**Подробное описание набора функциональных возможностей**

Новые компьютеры на модулях Comga-TS370 COM Express Basic Type 6 выпускаются с шестиядерными процессорами Intel® Xeon® и Intel® Core™ i7 или четырёхъядерными процессорами Intel® Core™ i5 требованиями по теплоотводу cTDP (Custom TDP) от 35 до 45 Вт и до 32 Гб памяти DDR4 2666 с опцией ECC. Интегрированная графика Intel® UHD630 через DP 1.4, HDMI, eDP и LVDS поддерживает до трех независимых 4k-дисплеев с частотой кадров до 60 Гц. Впервые разработчики могут перейти от eDP к LVDS исключительно с помощью программного обеспечения без какого-либо внесения изменения в оборудование. Модули отличаются высокой пропускной способностью ввода / вывода (I/O) и в том числе содержат 4x USB 3.1 Gen 2 (10 Гбит/с), 8x USB 2.0 и 1x PEG и 8 PCIe Gen 3.0 для мощных системных расширений, включая память Intel® Optane™. Что касается операционных систем, то исполняемыми являются все обычные операционные системы Linux, а также 64-разрядные версии Microsoft Windows 10 и Windows 10 IoT. Индивидуальная интеграционная поддержка премиум-класса в сочетании с широким ассортиментом доступных аксессуаров, а также стандартизованные или заказные по требованию заказчика несущие платы и системы дополняют пакет услуг, предлагаемых компанией новых модулей.

Новые компьютеры на модулях conga-TS370 COM Express Type 6 уже сейчас можно заказать в следующих стандартных конфигурациях:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Процессор** |  | **Число ядер / потоков** |  | **Тактовая частота****стандарт/ турбо, ГГц)** |  | **Кэш, Мб** |  | **Мощность TDP / cTDP, Вт** |
| Intel® Xeon® E-2176M |  | 6 / 12 |  | 2.7 / 4.4 |  | 12 |  | 45 / 35 |
| Intel® Core™ i7-8850H |  | 6 / 12 |  | 2.6 / 4.3 |  | 9 |  | 45 / 35 |
| Intel® Core™ i5-8400H |  | 4 / 8 |  | 2.5 / 4.2 |  | 8 |  | 45 / 35 |

Более подробную информацию о новом conga-TS370 высокопроизводительном компьютере на модуле COM Express Type 6 модуле можно получить по ссылке: <https://www.congatec.com/ru/produkcija/com-express-type6/conga-ts370.html>

**О компании congatec**

Компания congatec является ведущим мировым поставщиком индустриальных компьютерных модулей с использованием стандартных форм-факторов COM Express, Qseven и SMARC, а также одноплатных компьютеров и услуг по разработке и изготовлению заказных изделий этого направления. Продукты компании congatec могут использоваться в самых различных отраслях промышленности и областях применения, таких как: оборудование промышленной автоматизация, медицина, развлечения, транспорт, телекоммуникации, контрольно-измерительное и испытательное оборудование, а также POS-терминалы. Основные знания и технические ноу-хау компании включают в себя уникальные расширенные функции BIOS, а также обширные программные пакеты поддержки драйверов и плат. После этапа разработки заказчикам предоставляется широкая техническая поддержка через развитую систему управления жизненным циклом продукта. Продукция компании производится специализированными поставщиками услуг в соответствии с современными стандартами качества. Штаб-квартира компании Congatec находится в г. Деггендорф, Германия, кроме того в настоящее компания имеет свои представительства в США, Тайване, Китае, Японии и Австралии, а также в Великобритании, Франции и Чехии. Дополнительная информация доступна на нашем веб-сайте [www.congatec.com](http://www.congatec.com) или через [Facebook](http://www.facebook.com/Congatec), [Twitter](https://mobile.twitter.com/congatecAG) и [YouTube](http://www.youtube.com/congatecAE).

\* \* \*

Intel и Intel Core, Xeon, Optane являются зарегистрированными товарными знаками корпорации Intel в США и других странах.